



www.lsi.com

COMUNICATO STAMPA

LSI accelera l'innovazione con una piattaforma custom silicon a 28nm

Una vasta famiglia di moduli di proprietà intellettuale pronti per l'uso e un'avanzata metodologia di progettazione velocizzano il time-to-market delle soluzioni System-on-Chip

ACCLERATING INNOVATION CONFERENCE, MILPITAS, Calif., ottobre 2010 – LSI Corporation (NYSE: LSI) ha annunciato la disponibilità della piattaforma "custom silicon", ovvero per chip personalizzati, da 28nm. L'offerta include un vasto portfolio di moduli di proprietà intellettuale (IP) e una metodologia di progettazione avanzata per la realizzazione di System-on-Chip (SoC). La piattaforma sfrutta l'esperienza di numerose generazioni di chip personalizzati e consente agli OEM di realizzare soluzioni altamente differenziate per applicazioni di rete di nuova generazione destinate a data center, imprese e fornitori di servizi.

La piattaforma da 28nm, che utilizza la tecnologia TSMC 28HP con gate metallici high-K, permette ai clienti di raggiungere livelli di integrazione su SoC senza precedenti, con prestazioni notevolmente migliorate e con un minore dispendio energetico. I clienti possono scegliere all'interno di una vasta famiglia di moduli IP pre-definiti, compresi serializzatori-deserializzatori (SerDes) ad alta velocità, soluzioni di protocollo, memorie ad alte prestazioni ed elevata densità, un PHY Ethernet 1000Base-T, motori Tarari® per l'ispezione approfondita dei pacchetti, processori digitali di segnale (DSP) StarCore™ e microprocessori ARM, MIPS e PowerPC®.

"Gli attuali sistemi di networking avanzato richiedono soluzioni hardware differenziate per poter gestire la crescita del traffico continuando a soddisfare le stringenti esigenze in termini di consumi energetici," dice Bryan Lewis, Research Vice President di Gartner. "Gli ASIC personalizzati permettono agli OEM di realizzare hardware su misura in grado di rispondere alle crescenti richieste dei clienti."

Rispetto alla precedente generazione, le specifiche di progetto a 28nm permettono di risparmiare fino al 40% sui consumi elettrici pur raddoppiando la densità e aumentando le prestazioni fino al 25%. Questo consente ai clienti di soddisfare le esigenze in termini prestazionali riducendo al contempo i costi del prodotto e del raffreddamento.

"L'incredibile crescita dei contenuti nelle infrastrutture di rete richiede soluzioni SoC a elevata integrazione che siano in grado di vincere le sfide su prestazioni e dissipazione del calore," ha detto Sudhakar Sabada, Senior Vice President e General Manager della Custom Solutions Division di LSI. "Con un portfolio di core IP già pronti per i chip e con un'esperienza multigenerazionale in implementazioni complesse e SoC personalizzati, LSI consente ai clienti di rispondere alle sfide della nuova generazione e li aiuta a differenziare i loro prodotti sul mercato."

La piattaforma a 28nm sfrutta un'esperienza di numerose generazioni nella progettazione di moduli IP per applicazioni di networking. Progettati per soddisfare le esigenze della nuova generazione di sistemi di rete, i moduli IP di LSI offrono margini molto ampi nella progettazione che permettono di adattarsi perfettamente ai difficili ambienti del mondo reale. Un'avanzata metodologia di progettazione comprende il design gerarchico e

funzionalità di "test insertion", che mettono i clienti in grado di velocizzare il time-to-market.

I kit di progettazione per la piattaforma a 28nm sono già disponibili. I primi progetti di chip personalizzati a 28nm sono attualmente in fase di sviluppo in collaborazione con diversi partner e i primi prototipi sono previsti nella prima parte del 2011. Maggiori informazioni è si trovano all'indirizzo <http://go.lsi.com/9zyw>.

Chi è LSI

LSI Corporation (NYSE: LSI) è uno dei principali produttori di tecnologie innovative su silicio, sistemi e software alla base di prodotti che creano, memorizzano e trasportano informazioni digitali. L'azienda offre un ampio catalogo di possibilità e servizi che comprende IC standard e chip personalizzati, adattatori, sistemi e software impiegati dai più noti marchi mondiali per creare le soluzioni leader sul mercato Storage e Networking. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.lsi.com.

Editor's Notes:

1. All LSI news releases (financial, acquisitions, manufacturing, products, technology, etc.) are issued exclusively by PR Newswire and are immediately thereafter posted on the company's external website, <http://www.lsi.com>.
2. LSI, the LSI & Design logo and Tarari are trademarks or registered trademarks of LSI Corporation.
3. The PowerPC name and logo are registered trademarks of IBM Corp. and used under license therefrom.
4. All other brand or product names may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Per maggiori informazioni:

LSI Logic S.r.l.

Alessandro Antonioli

Account Manager – Semiconductor Solution Group

LSI Logic S.r.l.

Tel: **+39 02 9039 4850**

Mobile: **+39 348 7373933**

Mailto: alessandro.antonioli@lsi.com

Ufficio Stampa Italia

Cynthia Carta Adv.

Advertising Communication

Via Monte Rosa, 74 – 20149 Milano

Ph. ++39(0)2 45484666

Fax ++39(0)2 45484685 Mobile++39 3385909592

e-mail cyncarta@cynthiacartaadv.it www.cynthiacartaadv.it